

ME-IO 18,8 DEV-KIT KMGY - Set de carcasa



2202527

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2202527>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



DEV-KIT ME-IO: incluye 1 carcasa ME-IO 18,8 y tecnología de conexión enchufable (HSCH con HSCP), suministrados en piezas individuales

Sus ventajas

- Montaje sin herramientas sencillo
- Conectores de bus para carril opcionales para una comunicación sencilla entre módulos
- Principio Lock and Release para el bloqueo automático y el aflojamiento intuitivo del conector de la conexión frontal
- Plástico conforme a UL94 V0: para requisitos exigentes en cuanto a inflamabilidad
- Tecnología de conexión frontal enchufable

Datos comerciales

Código de artículo	2202527
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	ACHEBD
Clave de producto	ACHEBD
GTIN	4055626141770
Peso por unidad (incluido el embalaje)	86 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	89 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

ME-IO 18,8 DEV-KIT KMGY - Set de carcasa



2202527

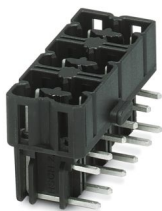
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2202527>

El set consta de

HSCH 2,5-3U/12 9005 - Carcasa de base para placa de circuito impreso

2201788

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2201788>



Carcasa base placa de circuito impreso, sección nominal: 2,5 mm², color: negro, corriente nominal: 8 A, tensión nominal (III/2): 320 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Macho, número de potenciales: 12, número de filas: 2, número de polos: 12, número de conexiones: 12, familia de artículos: HSCH 2,5/..-G, paso: 5 mm, montaje: Soldadura por ola, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 3,8 mm, número de pines de soldadura por potencial: 1, sistema enchufable: HSC 2,5, Orientación de la cara enchufable: Estándar, bloqueo: sin, tipo de sujeción: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja

HSCH 2,5-2U/ 8 9005 - Carcasa de base para placa de circuito impreso

2201789

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2201789>



Carcasa base placa de circuito impreso, sección nominal: 2,5 mm², color: negro, corriente nominal: 8 A, tensión nominal (III/2): 320 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Macho, número de potenciales: 8, número de filas: 2, número de polos: 8, número de conexiones: 8, familia de artículos: HSCH 2,5/..-G, paso: 5 mm, montaje: Soldadura por ola, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 3,8 mm, número de pines de soldadura por potencial: 1, sistema enchufable: HSC 2,5, Orientación de la cara enchufable: Estándar, bloqueo: sin, tipo de sujeción: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja

ME-IO 18,8 DEV-KIT KMGY - Set de carcasa



2202527

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2202527>

HSCP-SP 2,5-1U4-7035 - Conector para placa de circuito impreso

2201780

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2201780>



Conector de placa de circuito impreso, sección nominal: 2,5 mm², color: gris claro, corriente nominal: 8 A, tensión nominal (III/2): 320 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Hembra, número de potenciales: 4, número de filas: 2, número de polos: 4, número de conexiones: 4, familia de artículos: HSCP-SP 2,5-..., paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, gancho de sujeción: - Gancho de sujeción, sistema enchufable: HSC 2,5, bloqueo: sin, tipo de sujeción: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja, Color del contacto normalmente cerrado por resorte: naranja

ME-IO 18,8 C 2U 7035 - Tapa de la carcasa

2201799

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2201799>



Caja para carril DIN, 2U, Cubierta de caja, anchura: 18,9 mm, altura: 21,8 mm, profundidad: 26 mm, color: gris claro (similar RAL 7035)

ME-IO 18,8 DEV-KIT KMGY - Set de carcasa



2202527

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2202527>

HSC-LR 7U KIT 2003 - Bloqueo

2201795

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2201795>



Caja para carril DIN, 7U, Sistema Lock and Release, anchura: 16,1 mm, altura: 89,95 mm, profundidad: 8,8 mm, color: naranja (similar RAL 2003)

ME-IO 18,8 B/FE 9U TBUS 7035 - Parte inferior de la carcasa

2201809

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2201809>



Caja para carril DIN, Parte inferior de la carcasa con pasador de metal, con contacto de tierra funcional, con rendijas de ventilación, anchura: 18,9 mm, altura: 109,6 mm, profundidad: 64,3 mm, color: gris claro (similar RAL 7035), puenteado transversal: Conector de bus para carril DIN (opcional), número de polos conector transversal: 5

Datos técnicos

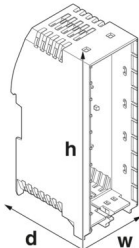
Notas

Recomendación:	Material de almohadillas de contacto para conectores de bus galvanico oro (oro duro)
----------------	--

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Set de carcasa
Tipo de carcasa	Caja para carril DIN
Tipo de carcasa	Carcasas multifuncionales
Serie de carcasas	ME-IO
Familia de productos	ME-IO 18,8
Número de polos máx.	28 (paso: 5 mm)
Orificio de ventilación disponible	sí

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	18,9 mm
Altura	113,3 mm
Profundidad	76,5 mm
Profundidad a partir del borde superior del carril DIN	70 mm

Diseño de las placas de circuito impreso

Espesor de placa de circuito impreso	1,4 mm ... 1,8 mm
--------------------------------------	-------------------

Datos del material

Color (Carcasa)	gris claro (RAL 7035)
Material	PA
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Código IP máximo alcanzable	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 105 °C (En función de la disipación)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 100 °C
Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte)	80 %

ME-IO 18,8 DEV-KIT KMGY - Set de carcasa



2202527

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2202527>

Datos de la placa de circuito impreso

Número de alojamientos de placa de circuito impreso	1
Tipo de fijación de placas de circuito impreso	Bloqueo
Espesor de placa de circuito impreso	1,4 mm ... 1,8 mm

Montaje

Tipo de montaje	Montaje sobre carril DIN
-----------------	--------------------------

Dibujos

Esquema de dimensiones

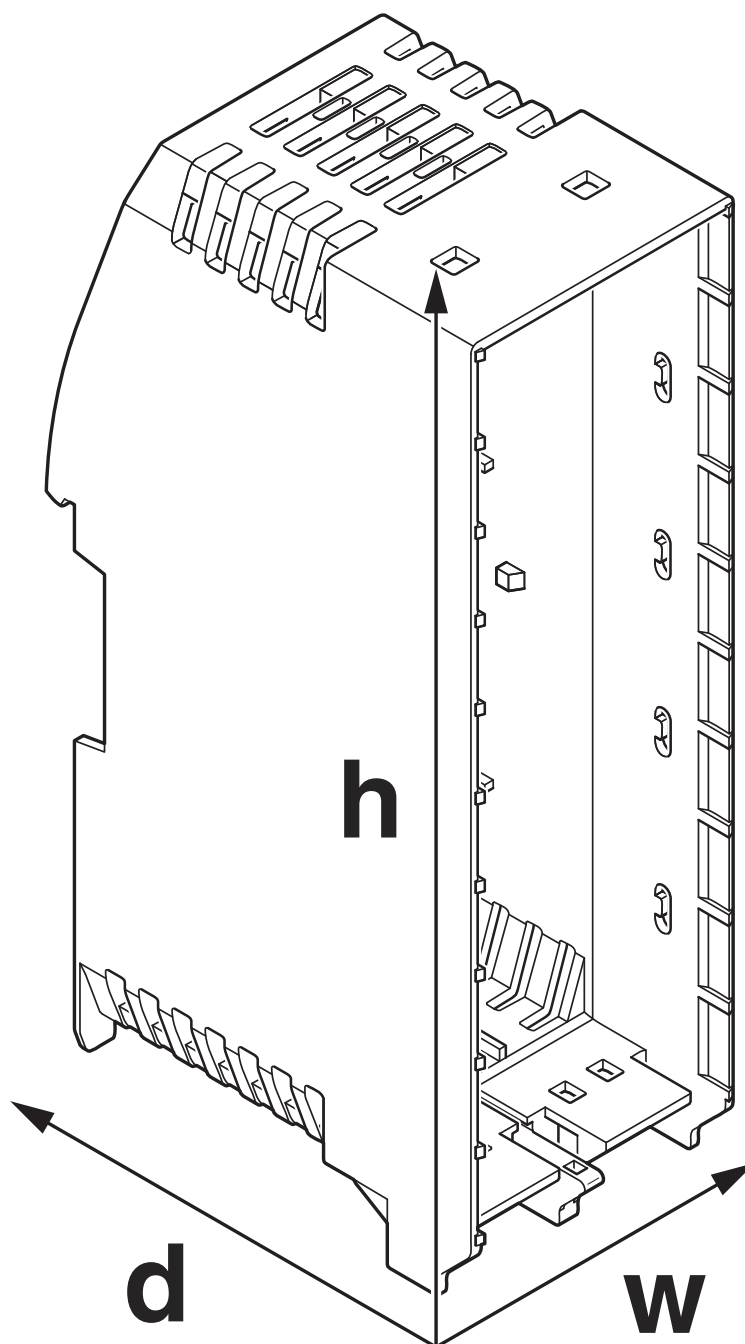


Figura esquemática para explicar las dimensiones del artículo. La figura no representa el producto deseado. Encontrará más detalles en los esquemas del producto, en la pestaña "Descargas".

ME-IO 18,8 DEV-KIT KMGY - Set de carcasa

2202527

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2202527>



Homologaciones

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2202527>



UL Recognized

ID de homologación: E240868

ME-IO 18,8 DEV-KIT KMGY - Set de carcasa



2202527

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2202527>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27190301
ECLASS-15.0	27190301

ETIM

ETIM 10.0	EC001031
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---